

科技部107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」
承諾書

本人承諾執行本計畫期間，不得執行本部其他計畫，惟因本
項計畫獲核定之大型儀器計畫不在此限。

立承諾人 簽名 _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日